

UDC 621.315.592  
H 80



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14844—93

---

## 半导体材料牌号表示方法

Designations of semiconductor materials

1993-12-24 发布

1994-09-01 实施

---

国家技术监督局 发布

# 中华人民共和国国家标准

GB/T 14844—93

## 半导体材料牌号表示方法

Designations of semiconductor materials

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了半导体多晶、单晶、晶片和外延片产品牌号的表示方法。

本标准适用于编制半导体材料的牌号。在编写国家标准和行业标准时，应采用本标准所规定的牌号表示方法。产品出厂时，应使用本标准规定的牌号标志。

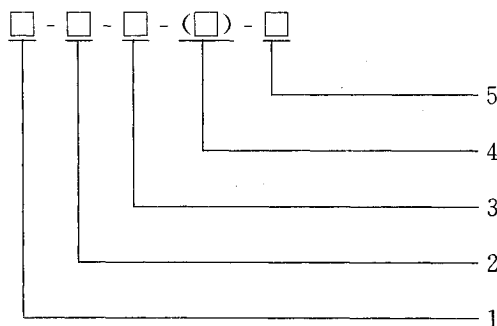
### 2 牌号分类

按照晶体结构和产品形状，半导体材料牌号分为多晶、单晶、晶片和外延片四类。

### 3 牌号表示方法

#### 3.1 多晶牌号

半导体多晶的牌号表示为：



1、2、3、4、5 分别代表牌号的第一项至第五项。

3.1.1 牌号的第一项表示多晶的生产方法或特殊用途，或生产方法与特殊用途的组合，分别用英文的第一个字母或其字母组合的大写形式表示，其中：

- a. C 表示铸造法；
- b. IR 表示红外光学用途；
- c. R 表示还原法；
- d. Z 表示区熔法。

3.1.2 牌号的第二项中 P 表示多晶，分子式表示多晶名称。

3.1.3 牌号的第三项表示多晶的形状，分别用英文第一个字母的大写形式表示，其中：

- a. I 表示棒状；
- b. N 表示块状。

3.1.4 牌号的第四项中括号内的元素符号表示掺杂剂。

3.1.5 牌号的第五项中用阿拉伯数字表示多晶产品的等级。